



Deutsches IMAPS-Seminar 2009 in Ilmenau

Nachdem das *IMAPS*-Frühjahrsseminar 2008 der *CICMT* in München weichen musste, fand es in diesem Jahr nunmehr zum zweiten Mal in Ilmenau statt. Diesmal stand es unter dem Motto *Ist Zuverlässigkeit noch bezahlbar?* Während die Anzahl der Aussteller mit 10 im Vergleich zum Seminar 2007 weitgehend konstant blieb, war mit 56 Besuchern doch ein merklicher Rückgang festzustellen. Dies dürfte weitgehend auf Reiserestriktionen in den Unternehmen aufgrund der gegenwärtigen Wirtschaftssituation zurückzuführen sein.



Das Hörsaalgebäude der TU Ilmenau bietet gute Bedingungen für Aussteller und Konferenzteilnehmer



Die Ausstellung im Foyer des Humboldt-Baus



Alexander Ferber (AEMtec) erhielt den Best Paper Award 2008

Die Podiumsvorträge in der Vormittagssession wurden von Vertretern der Automotive- beziehungsweise der Zuliefererbranche bestritten (*W. Pohlmann, Hella, Lippstadt, J. Graf, Bosch, Stuttgart, A. Wilkens, Daimler, Sindelfingen*) und beschäftigten sich mit LED-Modulen für Automotive-Anwendungen, Mikrosensoren beziehungsweise der Umstellung der Automobilelektronik auf Hochvoltbetrieb.

Alexander Ferber (AEMtec) erhielt von unserer 2. Vorsitzenden *G. Dittmar* den *Best Paper Award* für seinen Vortrag auf der *IMAPS*-Herbstkonferenz 2008 überreicht.

Nach der Kaffeepause trafen sich die Vortragenden des Vormittags zur Podiumsdiskussion, die von *Prof. Heinz Osterwinter (Hochschule Esslingen)* moderiert wurde.



Einige Neuheiten konnten auch körperlich begutachtet werden, (von rechts: *H. Osterwinter/HS Esslingen, W. Pohlmann/Hella, M. Detert/TU Dresden, M. Mach/TU Ilmenau, S. Seidmann/Du Pont*)



Hans-Ulrich Knipps während der Ausstellerpräsentation

Der Nachmittag war dann thematisch etwas vielfältiger. Der Bogen spannte sich von Zuverlässigkeitsproblemen bei medizinischen Implantaten (*J. Gossler, MSE, Berg*) über das Silbersintern als neue Verbindungstechnologie (*C. Mertens, VW, Wolfsburg*), Kontaktierungstechnologien für Flex-Verdrahtungsträger (*M. Deter, TU Dresden*) bis zu Prüfmethode für MIDs (*H. Kück, Hahn-Schickard-Gesellschaft, Stuttgart*). Die zweite Nachmittagssession umfasste nochmals drei Beiträge, wobei *B. Endress (Gramm Technik, Ditzingen)* über funktionelle Oberflächen sprach, während *O. Bochow-Neß* vom *IZM, Berlin*, neue Erkenntnisse zur Zuverlässigkeit von Systemen, Komponenten und Technologien vortrug. Thema des letzten Beitrags des Seminars (*J. Schalk, EADS, München*) waren die Möglichkeiten, die Mikrosysteme bei der Erhöhung der Zuverlässigkeit im Avionikbereich bieten.

Der organisatorische Ablauf wurde auch in diesem Jahr von den Mitarbeitern der *TU Ilmenau* (Nachwuchsforscherguppe *Funktionalisierte Peripherik* und Fachgebiet *Elektroniktechnologie*) sowie den *IMAPS*-Vorstandsmitgliedern sichergestellt.

Neues zur Zusammenarbeit mit IMAPS North America

Liebe *IMAPS* Deutschland Mitglieder,

zum Jahreswechsel haben wir Ihnen mitgeteilt, wie sich unsere Kollegen aus den USA die zukünftige Struktur von *IMAPS* vorstellen. Mit einer Überleitungsfrist in diesem Jahr sollten alle Mitglieder weltweit ab 2010 direkt vom *IMAPS*-Büro in Washington verwaltet werden. Das heißt Abführung der Mitgliederbeiträge und damit die Beschneidung der nationalen Möglichkeiten, Veranstaltungen zu organisieren und Mitgliederleistungen wie beispielsweise in Deutschland das Journal *PLUS* zu bezahlen.

Diese Planung, die sicherlich aus persönlichen Sichtweisen der jeweils gewählten *IMAPS*-NA-Präsidenten (einjährige Periode) resultiert, steht im deutlichen Widerspruch zu den Gründungszielen und dem Landesvereinsrecht der nationalen *IMAPS*-Organisationen. Die Ankündigung der amerikanischen Kollegen hat eine massive Welle des Protests in Europa und Asien ausgelöst. Die Ignoranz gegenüber den Reaktionen, die in Europa über das *European Liaison Committee* (Gremium besteht aus Vertretern aller europäischer Chapter) erfolgte, kann im schlimmsten Fall zu einer Abspaltung der Europäer und Asiaten von *IMAPS* führen. Vor diesem Hintergrund hat sich mittlerweile auch in den USA eine Initiative aus früheren *ISHM/IMAPS*-Präsidenten gebildet, die dem konstruktiv entgegenwirken möchten. Ich bin im Rahmen der *CICMT-Conference* in Denver (21./23. April 2009) von diesen Herren zu einer Diskussionsrunde eingeladen worden und hoffe, dass unsere Interessen verstanden werden. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser *PLUS* fand auch ein Treffen der Asiatischen *IMAPS*-Chapter in Kyoto statt. Ergebnisse aus beiden Runden werden wir Ihnen in den kommenden Ausgaben mitteilen.

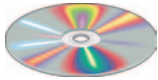
Jens Müller

Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
Brno	13./17.5.2009	ISSE 2009	IMAPS CZ+SK, IEEE
Rimini	14./17.6.2009	EMPC 2009	IMAPS Europe
Trento, IT	6./8.7.2009	MEMSWAVE conference	FBK, Amicom, EuMA
Tonsberg, NO	13./15.9.2009	Nordic Conference '09	IMAPS NORDIC
Pszczynna, PL	21./24.9.2009	IMAPS Poland conference	IMAPS Polen
München	27./28.10.2009	Herbstkonferenz 2009	IMAPS DE

Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings der *IMAPS-Herbsttagung 2008*, die am 14./15. Oktober 2008 in München stattgefunden hat, können auf CD zum Preis von



€ 55,-

und als Papiaerausdruck zum Preis von



€ 110,-

erworben werden.

Auch die Proceedings vorheriger *Herbsttagungen* und der *Deutschen IMAPS-Seminare 2006 zum Thema Muss jeder Sensor smart sein?* und 2007 zum Thema *Flip Chip – die Alternative zum Drahtbonden?* sind noch erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps, c/o Hesse & Knipps GmbH, Vattmannstraße 6, D-33100 Paderborn, Fax: 05251/1560-97, hans-ulrich.knipps@imaps.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß § 4 Nr. 22 UstG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland

Sie finden die neu gestalteten Webseiten von *IMAPS Deutschland* im Internet unter

<http://www.imaps.de>

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartner von *IMAPS Deutschland e.V.* Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.

Die internationalen Seiten von *IMAPS* erreichen Sie unter

<http://www.imaps.org>

oder für Europa:

<http://www.imapseurope.org>

Impressum

IMAPS Deutschland e.V.

1. Vorsitzender:

Prof. Dr.-Ing. Jens Müller

jens.mueller@imaps.de

Schatzmeister

(bei Fragen zu Mitgliedschaft und Beitrag):

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps

hans-ulrich.knipps@imaps.de

Ausführliche Kontaktinformationen zu den Vorstandsmitgliedern findet man unter www.imaps.de (*Vorstand*)

Flexible und starrflexible Leiterplatten

Von Wolfgang Reise, Klaus Ritz, et al., Erste Auflage 2006, ca. 125 Seiten mit 101 Abbildungen und 7 Tabellen. ISBN 3-87480-223-X. Preis € 58,- inkl. 7 % MwSt., zuzüglich Porto

Innerhalb der elektronischen Verbindungstechnik stellen flexible und starrflexible Leiterplatten ein Segment mit sehr hohem Wachstumspotential dar. In diesem Buch wird der gegenwärtige Stand der Produktion dieses Schaltungstyps beschrieben und die steigende Bedeutung dargestellt, die flexible und starrflexible Leiterplatten aufgrund ihrer Eigenschaften für die weitere Entwicklung der Verbindungstechnik in der Elektronik haben.

Das Buch behandelt insbesondere die Unterschiede zur Technologie und in der Applikation der starren Leiterplatte und stellt eine wichtige Informationsquelle für alle diejenigen in der Branche tätigen dar, die bisher „nur“ mit starren Leiterplatten befasst waren, sich aber nun mit diesem zukunftssträchtigen Gebiet der Leiterplatte beschäftigen wollen oder müssen. Es wendet sich vor allem auch an die Entwickler in den OEMs und möchte helfen, dass das Zukunftspotential der flexiblen und starrflexiblen Verbindungstechnik früher erkannt und stärker genutzt wird.

Eugen G. Leuze Verlag KG

Karlstraße 4 · D-88348 Bad Saulgau · Tel. 0 75 81/48 01-0 · Fax 0 75 81/48 01-10
e-mail: brigitte.brotzer@leuze-verlag.de · Internet: www.leuze-verlag.de